**附件一：授课老师简介**

|  |
| --- |
| 江建平博士：专注化学镀领域技术研发工作30余年，拥有完整的表面处理理论知识体系和丰富的实践管理经验，是化学镀领域知名的教授专家，专业技术水平世界领先。  发表了近40 篇学术论文及会议报告, 申请专利9项(授权4项)。曾担任《电镀与精饰》杂志编委。现担任中表协科技委委员,中国电子学会电镀专家委员会专家委员,新加坡江苏会副会长。 |
| **主要工作经历** |
| 1、1985～1993年 南京大学化学系讲师  ——参与国家《六、五》、《七、五》重点攻关项目；  ——分别荣获教育部科技进步奖、江苏省科学技术二等奖、南通市科学技术一等奖；  ——南京大学优秀青年教师奖  2、1997～2010年 乐思化学（确信电子）研发经理，亚太区研发与技术总监。  ——为公司研发、完善了近20种新产品及工艺，每年新增销售款超过2000万美元；  ——满足RoHS要求的化学镍获希捷电子、西部电子指定认证、2005年获确信电子集团总裁奖，为亚洲第一位获奖人；  ——高温有机保焊膜（OSP）整套产品研发、工艺优化，解决印制线路板数十年未能解决的问题－贾凡尼原电池腐蚀。OSP销售数年保持亚洲第一；  ——研发成功的锌锡合金电镀工艺获得日系汽车制造商（丰田、本田、尼桑等）验证及量产应用；  3、2011年至今 新加坡理工学院先进材料技术中心高级科学家、学术带头人／星材料股份有限公司总经理兼首席技术官。  ——水性封孔剂（SAM）——专利产品，获国际跨国企业验证并应用；  ——应用于柔性线路板的化学镍钯金工艺：a、低温柔性化学镍（65℃），b、高速长寿命化学钯，c、无氰低温置换金（<70℃）；  ——无EDTA、无氰、低温（45-50℃）高速化学铜工艺（>10μm／h）；  ——RoHS、超平滑、高速中高磷化学镍；  ——新型有机保焊膜（OSP）- 获著名台资企业验证并应用。 |